

2019-2025年中国半导体设备行业市场全景调研及 投资战略研究报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2019-2025年中国半导体设备行业市场全景调研及投资战略研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/detail/458402.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

在半导体行业的第三次景气周期中，手机等消费电子产品取代PC成为行业增长的主要驱动因素，中国是全球第一大消费电子生产国和消费国，对半导体产品的需求逐年快速提升。在消费电子产品需求的驱动下，半导体产业开始向中国大陆转移。如今中国已是全球半导体最大的销售市场。

在02专项、产业大基金的支持和培育下，我国半导体设备生产企业已经取得了一系列技术和产品的突破，多项专项项目结项，多种类、多型号半导体生产设备研发成功，且包括刻蚀机、薄膜沉积设备、清洗机等在内的关键半导体生产设备已在65-28nm制程晶圆产线上实现了批量应用，成为中芯国际等晶圆生产厂商的 baseline 机台，说明国产半导体设备已有进入主流晶圆生产线供货体系的能力。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 半导体设备行业基本概述

1.1 半导体的定义和分类

1.1.1 半导体的定义

1.1.2 半导体的分类

1.1.3 半导体的应用

1.2 半导体设备行业概述

1.2.1 行业基本界定

1.2.2 晶圆制造设备

1.2.3 晶圆加工设备

1.2.4 封装测试设备

第二章 2017-2018年中国半导体设备行业发展环境PEST分析

2.1 政策环境 (Political)

2.1.1 半导体行业政策汇总

2.1.2 半导体制造利好政策

2.1.3 智能传感器产业指南

2.1.4 产业投资基金的支持

2.2 经济环境 (Economic)

2.2.1 宏观经济发展现状

2.2.2 工业经济运行状况

2.2.3 固定资产投资分析

2.2.4 经济转型升级态势

2.2.5 未来经济发展展望

2.3 社会环境 (Social)

2.3.1 互联网运行状况

2.3.2 可穿戴设备普及

2.3.3 研发经费投入增长

2.3.4 科技人才队伍壮大

2.4 技术环境 (Technological)

2.4.1 企业研发投入

2.4.2 技术迭代历程

2.4.3 企业专利状况

第三章 2017-2018年半导体产业链发展状况

3.1 半导体产业链分析

3.1.1 半导体产业链结构

3.1.2 半导体产业链流程

3.1.3 半导体产业链转移

3.2 2017-2018年全球半导体市场总体分析

3.2.1 产业商业模式

3.2.2 市场销售规模

3.2.3 产业研发投入

3.2.4 销售收入结构

3.2.5 区域市场格局

3.2.6 市场竞争状况

3.2.7 资本支出预测

3.2.8 产业发展前景

3.3 2017-2018年中国半导体市场发展规模

3.3.1 行业发展历程

3.3.2 行业发展意义

3.3.3 市场发展态势

3.3.4 市场规模现状

3.3.5 市场发展形势

3.4 2017-2018年中国IC设计行业发展分析

3.4.1 行业发展历程

3.4.2 市场发展规模

3.4.3 企业发展状况

3.4.4 产业区域分布

3.4.5 细分市场发展

3.5 2017-2018年中国IC制造行业发展分析

3.5.1 制造工艺分析

3.5.2 晶圆加工技术

3.5.3 市场发展规模

3.5.4 晶圆制造工厂

3.5.5 企业竞争现状

3.6 2017-2018年中国IC封装测试行业发展分析

3.6.1 封装基本介绍

3.6.2 封装技术趋势

3.6.3 芯片测试原理

3.6.4 芯片测试分类

3.6.5 市场发展规模

3.6.6 企业竞争状况

3.6.7 技术发展趋势

第四章 2017-2018年半导体设备行业发展综合分析

4.1 2017-2018年全球半导体设备市场发展形势

4.1.1 市场销售规模

4.1.2 细分市场结构

4.1.3 区域格局分布

4.1.4 市场竞争格局

4.1.5 市场发展预测

4.2 2017-2018年中国半导体设备市场发展现状

4.2.1 市场销售规模

4.2.2 细分市场结构

4.2.3 市场竞争格局

4.2.4 市场国产化趋势

4.2.5 市场空间测算

4.3 半导体设备需求市场发展机遇

4.3.1 产能扩张态势

4.3.2 生产水平现状

4.3.3 产线技术迭代

4.4 半导体产业链核心设备市场发展空间

4.4.1 晶圆制造设备

4.4.2 晶圆加工设备

4.4.3 封装测试设备

第五章 2017-2018年中国半导体核心设备发展综合分析

5.1 2017-2018年中国晶圆制造设备市场运行状况

5.1.1 设备基本概述

5.1.2 市场发展规模

5.1.3 市场竞争格局

5.1.4 核心环节分析

5.1.5 应用市场状况

5.2 2017-2018年中国晶圆加工设备市场运行状况

5.2.1 设备基本概述

5.2.2 市场发展规模

5.2.3 市场竞争格局

5.2.4 核心环节分析

5.2.5 应用市场状况

5.3 2017-2018年中国IC封测设备市场运行状况

5.3.1 设备基本概述

5.3.2 市场发展规模

5.3.3 市场竞争格局

5.3.4 核心环节分析

5.3.5 应用市场状况

第六章 2017-2018年半导体光刻设备市场发展分析

6.1 半导体光刻环节基本概述

6.1.1 光刻工艺重要性

6.1.2 光刻工艺的原理

6.1.3 光刻工艺的流程

6.2 半导体光刻技术发展分析

- 6.2.1 光刻技术原理
- 6.2.2 光刻技术历程
- 6.2.3 光学光刻技术
- 6.2.4 EUV光刻技术
- 6.2.5 X射线光刻技术
- 6.2.6 纳米压印光刻技术
- 6.3 2017-2018年光刻机市场发展综述
 - 6.3.1 光刻机工作原理
 - 6.3.2 光刻机发展历程
 - 6.3.3 光刻机产业链条
 - 6.3.4 光刻机市场规模
 - 6.3.5 光刻机竞争格局
 - 6.3.6 光刻机市场困境
- 6.4 光刻设备核心产品——EUV光刻机市场状况
 - 6.4.1 EUV光刻机基本介绍
 - 6.4.2 EUV光刻机市场销量
 - 6.4.3 EUV光刻机需求企业
 - 6.4.4 EUV光刻机研发分析

第七章 2017-2018年半导体刻蚀设备市场发展分析

- 7.1 半导体刻蚀环节基本概述
 - 7.1.1 刻蚀工艺介绍
 - 7.1.2 刻蚀工艺分类
 - 7.1.3 刻蚀工艺参数
- 7.2 干法刻蚀工艺发展优势分析
 - 7.2.1 干法刻蚀优点分析
 - 7.2.2 干法刻蚀应用分类
 - 7.2.3 干法刻蚀技术演进
- 7.3 2017-2018年全球半导体刻蚀设备市场发展状况
 - 7.3.1 市场发展规模
 - 7.3.2 市场竞争格局
 - 7.3.3 设备研发支出
 - 7.3.4 市场空间测算
- 7.4 2017-2018年中国半导体刻蚀设备市场发展状况
 - 7.4.1 市场发展规模

7.4.2 企业发展现状

7.4.3 市场需求状况

7.4.4 市场空间测算

第八章 2017-2018年半导体清洗设备市场发展分析

8.1 半导体清洗环节基本概述

8.1.1 清洗环节重要性

8.1.2 半导体清洗工艺

8.1.3 清洗设备的原理

8.2 2017-2018年半导体清洗设备市场发展状况

8.2.1 市场发展规模

8.2.2 市场竞争格局

8.2.3 市场发展机遇

8.2.4 市场发展趋势

8.3 半导体清洗机领先企业布局状况

8.3.1 迪恩士公司

8.3.2 盛美半导体

8.3.3 国产化布局

第九章 2017-2018年半导体测试设备市场发展分析

9.1 半导体测试环节基本概述

9.1.1 测试流程介绍

9.1.2 前道工艺检测

9.1.3 中后道的测试

9.2 2017-2018年半导体测试设备市场发展状况

9.2.1 市场发展规模

9.2.2 市场竞争格局

9.2.3 设备制造厂商

9.2.4 市场空间测算

9.3 半导体测试设备重点企业发展启示

9.3.1 泰瑞达

9.3.2 爱德万

9.4 半导体测试核心设备发展分析

9.4.1 测试机

9.4.2 分选机

9.4.3 探针台

第十章 2017-2018年半导体产业其他设备市场发展分析

10.1 单晶炉设备

10.1.1 设备基本概述

10.1.2 市场发展现状

10.1.3 主要企业分析

10.1.4 核心产品介绍

10.2 氧化/扩散设备

10.2.1 设备基本概述

10.2.2 市场发展现状

10.2.3 主要企业分析

10.2.4 核心产品介绍

10.3 薄膜沉积设备

10.3.1 设备基本概述

10.3.2 市场发展现状

10.3.3 主要企业分析

10.3.4 核心产品介绍

10.4 机械抛光设备

10.4.1 设备基本概述

10.4.2 市场发展现状

10.4.3 主要企业分析

10.4.4 核心产品介绍

第十一章 2017-2018年国外半导体设备重点企业经营状况

11.1 应用材料

11.1.1 企业发展概况

11.1.2 企业经营状况

11.1.3 企业业务分析

11.1.4 企业核心产品

11.1.5 企业发展前景

11.2 泛林集团

11.2.1 企业发展概况

11.2.2 企业经营状况

11.2.3 企业业务分析

11.2.4 企业核心产品

11.2.5 企业发展前景

11.3 阿斯麦

11.3.1 企业发展概况

11.3.2 企业经营状况

11.3.3 企业业务分析

11.3.4 企业核心产品

11.3.5 企业发展前景

11.4 东京电子

11.4.1 企业发展概况

11.4.2 企业经营状况

11.4.3 企业业务分析

11.4.4 企业核心产品

11.4.5 企业发展前景

第十二章 2017-2018年国内半导体设备重点企业经营状况

12.1 晶盛机电

12.1.1 企业发展概况

12.1.2 经营效益分析

12.1.3 业务经营分析

12.1.4 财务状况分析

12.1.5 核心竞争力分析

12.1.6 公司发展战略

12.1.7 未来前景展望

12.2 中电科电子

12.2.1 企业发展概况

12.2.2 企业经营状况

12.2.3 企业业务分析

12.2.4 企业核心产品

12.2.5 企业发展前景

12.3 捷佳伟创

12.3.1 企业发展概况

12.3.2 经营效益分析

12.3.3 业务经营分析

12.3.4 财务状况分析

12.3.5 核心竞争力分析

12.3.6 公司发展战略

12.3.7 未来前景展望

12.4 中微半导体

12.4.1 企业发展概况

12.4.2 企业经营状况

12.4.3 企业业务分析

12.4.4 企业核心产品

12.4.5 企业发展前景

12.5 北方华创

12.5.1 企业发展概况

12.5.2 经营效益分析

12.5.3 业务经营分析

12.5.4 财务状况分析

12.5.5 核心竞争力分析

12.5.6 公司发展战略

12.5.7 未来前景展望

12.6 上海微电子

12.6.1 企业发展概况

12.6.2 企业经营状况

12.6.3 企业业务分析

12.6.4 企业核心产品

12.6.5 企业发展前景

第十三章 半导体设备行业投资价值分析

13.1 半导体设备企业并购市场发展状况

13.1.1 企业并购历史回顾

13.1.2 行业并购特征分析

13.1.3 企业并购动机归因

13.2 中国半导体设备市场投资机遇分析

13.2.1 行业投资机会分析

13.2.2 建厂加速拉动需求

13.2.3 产业政策扶持发展

13.3 半导体设备投资价值评估及建议

13.3.1 投资价值综合评估

- 13.3.2 市场进入时机判断
- 13.3.3 行业投资壁垒分析
- 13.3.4 行业投资风险提示
- 13.3.5 行业投资策略建议

第十四章 中国半导体设备行业标杆企业项目投资建设案例深度解析

- 14.1 半导体湿法设备制造项目
 - 14.1.1 项目基本概述
 - 14.1.2 投资价值分析
 - 14.1.3 建设内容规划
 - 14.1.4 资金需求测算
 - 14.1.5 实施进度安排
 - 14.1.6 经济效益分析
- 14.2 高端半导体设备扩产升级项目
 - 14.2.1 项目基本概述
 - 14.2.2 投资价值分析
 - 14.2.3 建设内容规划
 - 14.2.4 资金需求测算
 - 14.2.5 实施进度安排
 - 14.2.6 经济效益分析
- 14.3 光刻机产业化项目
 - 14.3.1 项目基本概述
 - 14.3.2 投资价值分析
 - 14.3.3 建设内容规划
 - 14.3.4 资金需求测算
 - 14.3.5 实施进度安排
 - 14.3.6 经济效益分析

第十五章 2019-2025年中国半导体设备行业发展趋势及预测分析

- 15.1 中国半导体设备需求市场发展利好
 - 15.1.1 物联网领域
 - 15.1.2 工业互联网领域
 - 15.1.3 人工智能领域
 - 15.1.4 汽车电子领域
 - 15.1.5 5G商用领域

15.2 中国半导体设备行业发展前景展望 (AK CY)

15.2.1 行业发展机遇

15.2.2 行业发展方向

15.2.3 未来发展趋势

15.3 2019-2025年半导体设备行业发展预测分析

15.3.1 2019-2025年半导体设备行业影响因素分析

15.3.2 2019-2025年半导体设备行业销售规模预测

图表目录：：

图表 半导体分类结构图

图表 半导体分类

图表 半导体分类及应用

图表 集成电路工艺流程对应的设备

图表 亚微米CMOS-IC制造厂典型的硅片流程模型

图表 光刻的8个步骤

图表 光刻技术的工艺原理图

图表 各种类型的CVD反应器及其主要特点

图表 我国半导体行业相关政策梳理

图表 《中国制造2025》半导体产业政策目标与政策支持

图表 2015-2030年IC产业政策目标与发展重点

图表 截止2018年大基金投资的企业

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.huaon.com/detail/458402.html>